

2024年9月25日

## 日清エンジニアリング 「TOKYO PACK 2024 - 東京国際包装展 - 」に出展 ~エ場・生産設備のエンジニアリングカをアピール~

日清製粉グループの日清エンジニアリング株式会社(取締役社長:後藤 卓弘)は、本年10月23日(水)~25日(金)の3日間、東京ビッグサイト(東京都江東区有明)で開催される「TOKYO PACK2024-東京国際包装展-」に出展します。

## ■ ブース概要(小間番号:東5ホールC-21)

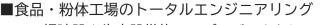
当社ブースでは、食品や粉体等を取り扱う工場・生産設備のトータルエンジニアリングを提案します。特に、粉体ハンドリング技術として、少量多品種生産に適したバッチ連続システムである「マトコン・コンテナシステム」を紹介します。

## ≪主な出展内容≫

■マトコン・コンテナシステム

粉体用コンテナを用いたバッチ連続システムで、コンタミネーションリスクの低減を可能にし、少量多品種生産に適しています。ブース内ではLEDパネルを用いて構造のイメージや製造フロー例を分かりやすく紹介します。

当社は2002年から英国マトコン社のエンジニアリング・パートナーとして「マトコン・コンテナシステム」をお客様へ導入しており、食品・医薬に加えて、化学、金属粉体や電子・電池材料粉体等、幅広い分野で採用されています。



工場建設や生産設備施工のプロジェクトについて、トータル

■「TOKYO PACK 2024-東京国際包装展-」概要

エンジニアリングの視点から、進め方・取り組み方のポイントを紹介します。また当社の工場 建設や生産設備施工の実績について、工場写真やミニチュア模型を展示します。



<ブースイメージ>



TOKYO PACK 2024は、包装資材、包装機械から包材加工機械、食品機械、関連機器類、環境対応機材、物流機器類に至る生産・包装・流通の技術振興をはかるとともに、相談や交流及び包装の最新情報発信の場として、国際的な視野に立った社会の発展に資することを目的とした、世界有数の国際総合包装展です。

·開催期間:2024年10月23日(水)~25日(金)

·開催時間:10:00~17:00

・会 場:東京ビッグサイト 東ホール(東京都江東区有明3-11-1)

· 主 催:公益社団法人日本包装技術協会

・Webサイト: https://www.tokyo-pack.jp/

以上

この件に関する報道関係者のお問い合わせ先

株式会社日清製粉グループ本社 総務本部 広報部 担当:神田・清水電話:03-5282-6650(お問い合わせフォームはこちら)